



部品内蔵技術委員会主催 2024年度第一回公開研究会

主催：部品内蔵技術委員会

◆公開研究会のご案内

研究会テーマ「部品内蔵技術と高密度・高機能化を支える実装材料」

エレクトロニクス実装学会部品内蔵技術委員会(委員長・猪川幸司:日本シイエムケイ)では、下記要領で2024年度第一回公開研究会を開催致します。今回は、最新部品内蔵基板技術の特別講演を含めた2件の部品内蔵技術関連の講演と、今後の実装技術において高密度・高機能化を支える実装材料に関する3件の講演となっています。奮ってご参加下さい。

開催日時 2024年6月27日(木) 13:10~17:00

開催方式 現地開催 & WEB (Zoom Webinarシステム利用)ハイブリッド

開催場所: 回路会館地下1F会議室

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

13:10~13:15

オープニング

開会挨拶 部品内蔵技術委員会技術調査研究会 藤村 迅 主査

13:15~14:15

特別講演 「最新部品内蔵基板技術」

インターコネクション・テクノロジーズ 宇都宮 久修 氏【WEB講演】

<概要>最先端パッケージングで用いられるシリコンブリッジ内蔵技術などの基板内蔵技術の最新の動向と部品内蔵基板の拡張性などについて解説します。

14:20~14:55

一般講演① 「部品内蔵技術による基板小型化の実現と電源品質評価」

株式会社メイコー 戸田 光昭 氏【現地講演】

<概要>表面実装部品を内蔵することができ、リフロー耐熱性が高いSn-Sb系高融点はんだ部品内蔵基板を開発したこの技術を用いてコネクタ実装構造の制御基板と電源基板の2枚の基板を1枚の基板に小型化し、基板面積の半減と実装部品を含めた占有体積の削減を実現した。この技術の特徴を生かした設計方法、基板製造および製造検査結果、代表特性である電源/GND電位3.3V系の主要半導体のZ11評価結果を報告する。更に、2022年から様々な分野のお客様に向けて提供している高周波技術および放熱技術のエンジニアリングサービスの代表事例も合わせて紹介する。

(休憩10分)

15:05~15:40

一般講演② 「微細配線対応銅めっきおよびエッチングプロセス」

株式会社JCU 大野 晃宜 氏【現地講演】

<概要>最近、More Than Mooreの動きが激しくなり、Advanced Packaging用の動きが盛んである。積層方法は、2Dから2.xDや3Dへと変化し、ますます微細配線化が必要となって来ている。そのため本報では、RDL用途の硫酸銅めっきおよびエッチングプロセスの性能と原理について紹介する。

15:45~16:20

一般講演③ 「密着性向上効果のあるゾルゲル処理剤」

ハニー化成株式会社 臼井 寛明 氏【現地講演】

<概要>当社はアルコキシシランのゾルゲル反応を利用した処理剤を上市している。これまで当社はガラスにスプレー塗装することで、凹凸形状を有する塗膜を形成できることからディスプレイやカバーガラスなどに防眩性付与するためにこれまで検討してきた。最近、ガラスや金属に密着性が良く、塗膜が凹凸形状を有する特性をもつことから、構造接着により樹脂材料との密着性の向上が可能であることがわかり、新たな用途展開としてガラスや金属と樹脂の異種材料耐熱接着剤なども現在検討している。当日は、当社のゾルゲル処理剤について紹介する。

16:25~17:00

一般講演④ 「ファインピッチ向け異方性導電膜(ACF)の開発動向と用途展開」

デクセリアルズ株式会社 大関 裕樹 氏【現地講演】

<概要>近年、ディスプレイは狭額縁化・小型化・高精細化によるファインピッチ化が進行、それに伴い接続面積や端子間隔が縮小しています。ディスプレイの技術トレンドにおける実装課題解決に向け、デクセリアルズの異方性導電膜(ACF)の取り組みと、ディスプレイのみならず、ACFの更なる用途展開についてご紹介します。

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

参加要項

定員 回路会館地下1F会議室:50名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)
WEB (Zoom Webinar): 200名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参加費(消費税込み)

正会員:5,000円、学生会員:1,000円、研究会会員:別払い、シニア会員:2,000円

名誉会員:無料、賛助会員の社員:5,000円、賛助会員(クーポン利用):無料

非会員一般:15,000円、非会員学生:2,000円、協賛団体(JPCA会員):5,000円

注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されますと、**返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。
- ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。
(お支払い方法:銀行振込・クレジットカード決済)
- ③請求書や振込確認後の領収書のご発行は、返信メールのマイページから出力が可能です。
- ④WEBの請求書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
- ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで(複数口の場合は口数分)利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。※複数枚使用希望がある場合はお問い合わせください。
*キャンセルポリシー
- ⑥参加費決済方法:クレジットカード決済か銀行振込をご選択いただけます。
銀行振込の場合の振り込み先は、マイページ「決済」タブより出力いただく請求書の下部をご確認ください。
*キャンセルポリシー
お申込み後のキャンセルはできません。

下記から参加申し込みをお願いします。

会員

賛助会員

協賛会員

非会員

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会
E-mail: info¥jiep.or.jp(メールアドレスは¥を@に置き換えてください)